

功率半導體集團及產能

目錄

一、前言.....	1
二、先說結論：.....	1
三、強茂 2481.....	2
四、台半 5425.....	3
五、德微 3675.....	4
六、富鼎 8261.....	4
七、大中 6435.....	5
八、茂達 6138.....	5

一、前言

- (一)、功率半導體近期強勢，且逐漸醞釀缺貨漲價的題材，以缺貨來說能夠搶到產能至關重要，像是本身自有產能或有集團在背後支持去搶產能，都是很需要了解的部分
- (二)、因小弟在下我不是業內人士，僅能以公開資料去拼湊下面的資訊，尤其是代工、封測的上下游部分相當不熟悉，更別提供貨比重的，若有懂行的業內大神，也不吝指教

二、先說結論：

- (一)、IDM 組的強茂、台半、德微，個人偏好強茂
- (二)、Fabless 組的偏好富鼎>茂達>大中
- (三)、強茂：
 - 1. 自有產能，垂直整合
 - 2. 沒有看到其他集團和股東的支援
 - 3. 機會：不用被母集團壓價格
 - 4. 風險：產能可能就有限，要去搶委外代工的晶圓代工或封測都需要本事，沒有幫手
- (四)、台半：
 - 1. 自有產能，垂直整合
 - 2. 有聯電支持，表面上是有聯盟，實際上聯電只持有 2.7% 的股權
 - 3. 機會：算是獨立自主不用被母集團壓價格
 - 4. 風險：營收有一半非半導體，估值上要打個折，不能直接拿獲利去乘上倍數
 - 5. 查完資料以後就覺得數據偏不透明，其他公司有揭露的東西他都沒有，感覺很像是家族事業的樣態，股權結構來說可能也是，沒那麼喜歡
- (五)、德微
 - 1. 自有產能，垂直整合
 - 2. 有母公司集團的支援沒錯，但母公司控股過半，看起來就很像是母公司的代工廠似的
 - 3. 機會：有富爸爸可以靠
 - 4. 風險：有六成是供貨給母集團，很難確定被母集團殺價損失的比較多，富爸爸幫忙拿到的產能轉出獲利比較多

5. 德微的法說會簡報挺不錯的，老闆給人有種務實且實事求是的感覺

(六)、富鼎 8261

1. 無自有產能，委外製造
2. 背後有國巨集團和鴻海集團可以罩，持股約三成
3. 機會：兩大集團的資源很強，搶產能不會輸，高壓產品佔了 12%
4. 風險：要考慮會不會出貨給兩大集團時被殺價，但持股不至於過半，風險比德微的風險小很多

(七)、大中 6435

1. 無自有產能，委外製造
2. 背後茂達集團持股達 42.6%，茂達背後又有國巨集團，而大中的產品有點像是幫母公司茂達製造
3. 機會：茂達集團和國巨集團的資源，搶產能較強
4. 風險：以茂達的持股比例偏高，也可能被母集團壓價格，產品組合裡面高壓產品僅佔 1%，不如富鼎

(八)、茂達 6138

1. 無自有產能，委外製造
2. 泛國巨集團持股超過三成，搶產能較強
3. 機會：有國巨集團的資源，也可以壓榨子公司大中
4. 風險：其實還好，國巨集團的持股比例大約 30%不接近一半，小小擔憂會不會被殺價

三、強茂 2481

(一)、產品結構：功率分離式元件 91.79%、功率積體電路及元件 6.51%。
公司於車用 MOSFET 市場滲透率持續提升，產品組合優化為近幾年毛利率改善主因

1. 產品應用：1Q26 營收比重分別占車用電子 35%、消費型電子 19%、電腦運算 18%、工控綠能 13%、電源供應 11%、通訊 4%
2. 主要產品包含
 - (1). 二極體 44%：Schottky 26%、Rectifier 12%和 Switching 6%
 - (2). MOSFET 33%
 - (3). 保護元件 19%：TVS 9%、Zener 6%、ESD 4%

(4). 高階產品：BJT 3%和 SiC 1%

3. 預期今年 AI 營收占比可望由 10%上修至 10-15%

4. 亮點：高壓 Super Junction

(二)、隸屬集團：無，本身就是強茂集團主體

(三)、背後上市櫃大股東：無

(四)、底下上市櫃子公司：虹冠電 3257，轉投資榮茂光學 4729、凡甲 3526

(五)、現有產能：自有產能，三座晶圓廠以及 5 座封裝廠，為全球第五大整流元件製造商

(六)、擴建中產能：2025 年擴菲律賓封裝廠，2025 年 12 月收購越南廠，2026 年 Q3 車規產品進入量產

(七)、委外晶圓代工產能：查無資料

四、台半 5425

(一)、產品結構：功率半導體與分離式元件，整流器相關產品占約 42.9%，另有子公司鼎翰科技貢獻 57.1%，為條碼列印機相關產品

1. 產品應用：1H2025 車用電子佔 56%，工控佔 15%、消費電子佔 27%、其他 2%

2. 核心能力在離散功率整流器，並包含 MOSFET、功率電晶體、LED driver IC、類比 IC、ESD 等

3. 亮點：AI 電源應用所需的 Super Junction MOSFET

(二)、隸屬集團：無，本身就是台半集團主體

(三)、背後上市櫃大股東：

1. 最大股東為鼎翰科技 3611，持股約 6.06%，但這是集團內交叉持股關係

2. 聯電旗下的宏誠創投取得台半增資後約 2.7%的股權

(四)、底下上市櫃子公司：最重要的子公司為鼎翰科技 3611，但主要業務為條碼列印機、標籤與相關耗材

(五)、現有產能：主要 4 處生產據點，在宜蘭(封測)、利澤(4/6 吋晶圓製造)以及中國天津(4 吋晶圓製造)、山東(封測)

(六)、擴建中產能：查無

(七)、委外晶圓代工產能：三成委外，聯電為其代工對象

(八)、和封測廠關係：自有集團內可封測

五、德微 3675

(一)、產品結構：功率分離式元件與晶圓

1. 營收比重：二極體及電晶體 64%、晶圓 33.65%

2. 主要產品包含：

(1). 二極體：蕭特基二極體(Schottky)、整流二極體(Rectifier)、超快速整流二極體(Super Fast)、穩壓二極體(Zener)、高效率整流二極體(Efficient Rectifier)、橋式二極體(Bridge)、瞬態抑制二極體(TVS)、碳化矽二極體(SiC SBD)、靜電保護二極體(ESD)。

(2). MOSFET/Transistor/ESD Array

(3). 晶圓：Thyristor、FRED、Schottky、TVS、Zener。

(二)、隸屬集團：達爾科技集團，持股 52.63%。

1. 六月的法說會提到：目前全數代工客戶中，扣除母公司達爾的六成外，外部四成客戶已經全面調漲

(三)、背後上市櫃大股東：美國半導體製造商達爾科技

(四)、底下上市櫃子公司：亞昕科技 5213，是重要晶圓製造相關子公司

(五)、現有產能：自有晶圓廠，目前 TVS 相關晶圓月產量已增至 1 萬多片，接近 2 萬片

(六)、擴建中產能：未來一年內將推動 4 吋產線全面升級至 5 吋，部分產能進一步導入 6 吋製程

(七)、委外晶圓代工產能：交由子公司亞昕科技

六、富鼎 8261

(一)、產品結構：公司目前基本盤在傳統功率元件與電源管理相關應用

1. 營收主體以低壓與中壓 MOSFET 為主，2026Q1 低壓占比 52%、中壓約 34%，高壓 MOSFET 約 12%

2. 產品線：SPS 佔 41%、DC Fan 佔 35%、Computing 佔 11%、Display 佔 3%、Others 佔 10%

3. 亮點：高壓 Super Junction

(二)、隸屬集團：國巨-鴻海半導體聯盟，現階段較偏國巨主導，最大法人股東為國創半導體

(三)、背後上市櫃大股東：國創半導體持股 29.44%，背後為國巨 2327 與鴻海 2317，目前由國巨持股 55%，鴻海持股 45%，董事長由國巨集團董事長陳泰銘擔任

(四)、底下上市櫃子公司：無

(五)、現有產能：為 IC 設計公司，無產能，委外製造

(六)、擴建中產能：為 IC 設計公司，無產能，委外製造

(七)、委外晶圓代工產能：

1. 主要供應廠商為力積電、華虹、茂矽、漢磊

2. 四月法說會報告顯示高壓產品產能已提前預訂，受此因素影響可能會有生產遞延的情況，但不致於出現產能不足的情況

3. 高壓 MOSFET 晶圓代工為三星

七、大中 6435

(一)、產品結構：功率半導體元件(MOSFET & IGBT)及高壓積體電路(HV IC)設計公司

1. 低壓約 75%、中壓約 24%、高壓約 1%

2. 應用：PC 應用佔 41.28%、伺服器佔 36.37%、電池管理 BMS 佔 5.74%、SMPS 佔 3.58%、網通佔 2.45%

3. 亮點：Dr. MOS

(二)、隸屬集團：茂達 6138 旗下功率元件/MOSFET 子公司，持股達 42.6%，最新董事會已將推選陳泰銘為董事長

(三)、背後上市櫃大股東：茂達 6138，但茂達又被國巨持有，故為茂達旗下、泛國巨集團影響力延伸的 MOSFET 公司

(四)、底下上市櫃子公司：無

(五)、現有產能：無產能，屬 IC 設計/Fabless 型功率元件公司

(六)、擴建中產能：無產能，屬 IC 設計/Fabless 型功率元件公司

(七)、委外晶圓代工產能：世界先進、聯電

(八)、封裝測試：日月光、超豐、捷敏

八、茂達 6138

(一)、產品結構：類比與混合訊號 IC 設計公司

1. 營收占比：馬達驅動 IC 佔 45.1%、PWM IC 佔 26.6%、LDO 佔 25.4%

2. 應用營收比重：風扇 45.1%、儲存裝置佔 10.4%、主機板佔 10.6%、筆記型電腦佔 9.8%、記憶體佔 5.2%、消費性電子佔 4.6%

3. 主要產品：馬達驅動晶片、電源管理晶片、離散功率元件、LED 驅動晶片、音訊晶片、感測器、光學晶片

(二)、隸屬集團：國巨持有 22.13%，現在由陳泰銘出任董事長

(三)、背後上市櫃大股東：泛國巨集團持股超過三成，由國巨持有 22.13%，國新投資持有 1.76%，同欣電持有 1.74%，凱美持有 1.25%，旺詮持有 1.24%

(四)、底下上市櫃子公司：持有大中 42.6%

(五)、現有產能：無產能，本體是 Fabless / IC 設計公司

(六)、擴建中產能：無產能，本體是 Fabless / IC 設計公司

(七)、委外晶圓代工產能：聯電、世界先進

(八)、封測：日月光、超豐